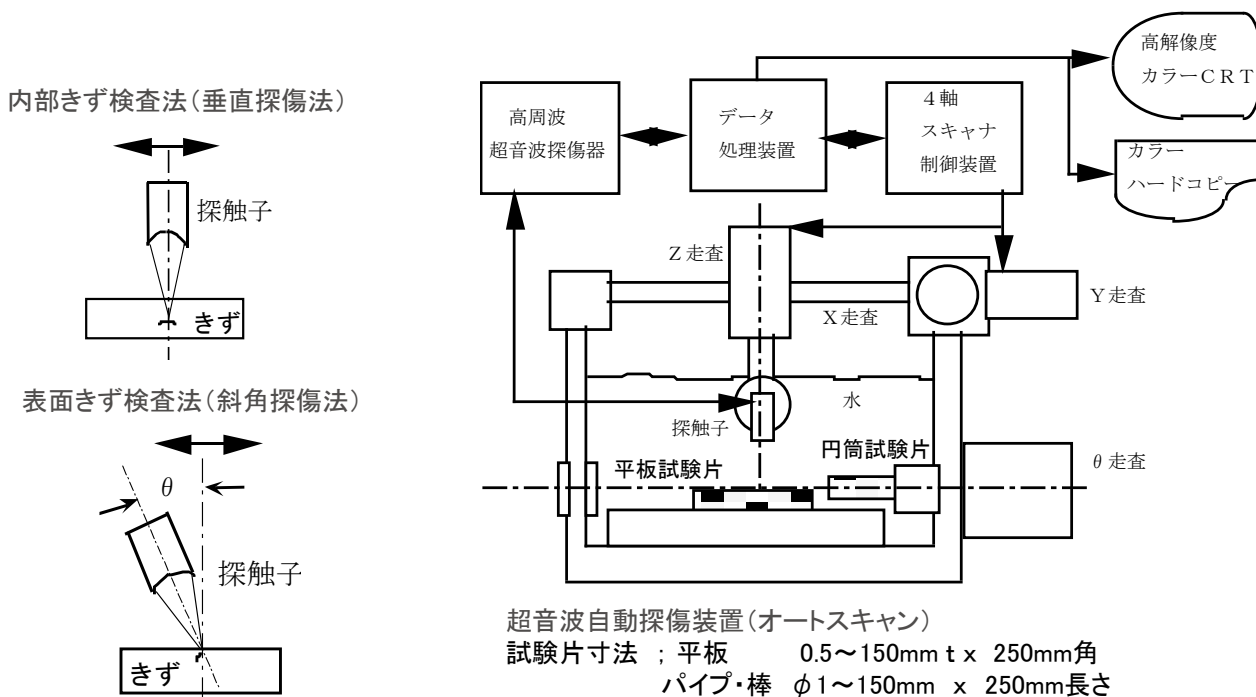


超音波自動探傷による微小きずの検出技術

微小な内部欠陥や表面欠陥(100 μ 程度)を検出し、その大きさ、形状、位置を平面図および断面図として出力します。

1. 検出原理

水槽中にセットした試験片に、細く絞った高周波の超音波ビーム(最大100MHz)をX、Y軸方向にスキャン(最小10 μ m)させて、試験片内部及び表面の微小きず(100 μ m前後)を検出し、測定結果を平面図(平面的な分布図)及び断面図(深さ位置図)でカラー映像化します。



2. 調査例



3. 応用例

鉄鋼製品の微小介在物、微小クラック検出、セラミックスの微小きず検出
電子部品の検査、鋳物等の巣の検査、その他各種金属、非金属材料の微小表面きずの検出